

## 铜核球 3D层叠封装用 pop封装 铜芯球 半导体封装植球

产品名称	铜核球 3D层叠封装用 pop封装 铜芯球 半导体封装植球
公司名称	海普半导体（洛阳）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:海普
公司地址	河南省洛阳市宜阳县锦屏镇产业集聚区电子电器 工业园1号
联系电话	18530006115 18530006115

### 产品详情

海普半导体（洛阳）有限公司是一家集研发、生产运营、销售服务为一体的高科技企业，业务范围包括：金属合金制品、电子和半导体材料及设备的生产与销售,焊接材料及设备的生产及销售，电子产品及设备的加工组装和销售，主要产品有：BGA锡球（SAC305无铅锡球、Sn63Pb37有铅锡球、Pb90Sn10高铅锡球、金锡焊球、编带锡球；熔点120-350 任意温度定制；0.05-1.8mm任意尺寸定制）、铜核球（镀锡铜核球、镀金铜核球）、CCGA焊柱（Pb90Sn10高铅焊柱、缠绕铜带增强螺旋焊柱、微弹簧焊柱）、铜柱、倒装/植球助焊剂flux、预成型焊料、金锡焊片、金锡盖板、焊锡膏、电镀锡球等，提供BGA植球CCGA植柱代加工服务，提供封装整体解决方案，代理各类半导体封装设备